

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年4月20日
【事業年度】	第116期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）
【会社名】	株式会社岡本工作機械製作所
【英訳名】	OKAMOTO MACHINE TOOL WORKS, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石井 常路
【本店の所在の場所】	群馬県安中市郷原2993番地
【電話番号】	(027) 385 - 5800
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 管理本部長 高橋 正弥
【最寄りの連絡場所】	群馬県安中市郷原2993番地
【電話番号】	(027) 385 - 5800
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 管理本部長 高橋 正弥
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成27年6月29日に提出した第116期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

- 第一部 企業情報
- 第2 事業の状況
- 6 研究開発活動

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____を付して表示しております。

第一部【企業情報】

第2【事業の状況】

6【研究開発活動】

（訂正前）

当社グループは、総合砥粒加工機メーカーとして顧客の高精度要求に対応していくため、「究極の平面創成」をスローガンに、平面加工（研削・研磨）の分野において世界で最高峰の技術を目指すことを主要な開発テーマとしております。

当連結会計年度における研究開発費の総額は115百万円であります。

また、当社グループの研究・開発・技術スタッフは101名で、全従業員の5.6%に当たります。

なお、セグメント別の状況は次のとおりであります。

(1) 工作機械

平面研削盤関連につきましては、安定した精度確保と操作性の向上を目的とした“コラム形構造タイプ”のシリーズ（CAシリーズ）は、ユニット選択により要求精度及びアプリケーションに幅広く対応できる“モジュラー設計”を採用し、中でも最も市場の大きい小型シリーズの開発を完了させ市場投入を開始いたしました。

日本市場投入後好評を得ております門型構造を採用した大物加工用CH-iQシリーズは、高能率加工に対応するオプションを搭載し米国・欧州への販売を開始しました。

また、成型研削盤につきましては、同上CAシリーズをベースマシンとし、各種機械要素の高精度化に加え、テーブルの駆動方式にリニアモータを採用した小・中金型部品加工用の高精度・高能率成型研削盤を開発し、同様のコンセプトによる従来シリーズ（UPZシリーズ）の拡充を図っております。

その他、周辺装置につきましては、引き続き研削加工における更なる自動化・無人化への流れに対応すべく、加工部品の自動測定装置及び測定結果による自動補正研削システムの実現を、また、要素開発におきましては、より高精度な平面研削盤に適した当社独自の軸送り案内についての検討・試作をなど、日々、様々なテーマを掲げ研究を行っております。

(2) 半導体関連装置

半導体デバイスウェーハ関連では、3次元実装の量産化を目指す海外アッセンブリ・デバイスメーカーに対し、日々の加工テストによる試行錯誤を通じ、より一層のコストダウンを踏まえた製造プロセスを提案し、更には、その具体的な実現を想定した実加工機の開発に取り組んでおります。

また、年々市場が拡大し注目度が増しておりますパワーデバイス関連材料であるSiC、GaN、及びスマートフォンに採用されるSAWフィルター用のLT（リチウムタンタレート）やLN（リチウムニオベート）等、特殊材料の加工に特化した更なる高剛性・高能率の研削盤、ラップ盤及びポリッシュ盤の開発に注力してまいります。

(訂正後)

当社グループは、総合砥粒加工機メーカーとして顧客の高精度要求に対応していくため、「究極の平面創成」をスローガンに、平面加工（研削・研磨）の分野において世界で最高峰の技術を目指すことを主要な開発テーマとしております。

当連結会計年度における研究開発費の総額は115百万円であります。

また、当社グループの研究・開発・技術スタッフは101名で、全従業員の5.6%に当たります。

なお、セグメント別の状況は次のとおりであります。

(1) 工作機械

平面研削盤関連につきましては、安定した精度確保と操作性の向上を目的とした“コラム形構造タイプ”のシリーズ（CAシリーズ）は、ユニット選択により要求精度及びアプリケーションに幅広く対応できる“モジュラー設計”を採用し、中でも最も市場の大きい小型シリーズの開発を完了させ市場投入を開始いたしました。

日本市場投入後好評を得ております門型構造を採用した大物加工用CH-iQシリーズは、高能率加工に対応するオプションを搭載し米国・欧州への販売を開始しました。

また、成型研削盤につきましては、同上CAシリーズをベースマシンとし、各種機械要素の高精度化に加え、テーブルの駆動方式にリニアモータを採用した小・中金型部品加工用の高精度・高能率成型研削盤を開発し、同様のコンセプトによる従来シリーズ（UPZシリーズ）の拡充を図っております。

その他、周辺装置につきましては、引き続き研削加工における更なる自動化・無人化への流れに対応すべく、加工部品の自動測定装置及び測定結果による自動補正研削システムの実現を、また、要素開発におきましては、より高精度な平面研削盤に適した当社独自の軸送り案内についての検討・試作をなど、日々、様々なテーマを掲げ研究を行っております。

当セグメントに係る研究開発費は77百万円であります。

(2) 半導体関連装置

半導体デバイスウェーハ関連では、3次元実装の量産化を目指す海外アッセンブリ・デバイスメーカーに対し、日々の加工テストによる試行錯誤を通じ、より一層のコストダウンを踏まえた製造プロセスを提案し、更には、その具体的な実現を想定した実加工機の開発に取り組んでおります。

また、年々市場が拡大し注目度が増しておりますパワーデバイス関連材料であるSiC、GaN、及びスマートフォンに採用されるSAWフィルター用のLT（リチウムタンタレート）やLN（リチウムニオベート）等、特殊材料の加工に特化した更なる高剛性・高能率の研削盤、ラップ盤及びポリッシュ盤の開発に注力してまいります。

当セグメントに係る研究開発費は38百万円であります。